



## 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年5月11日  
上場取引所 東

上場会社名 株式会社 東京精密  
コード番号 7729 URL <http://www.accretech.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役業務会社執行役員社長  
定時株主総会開催予定日 平成23年6月27日  
有価証券報告書提出予定日 平成23年6月29日  
決算補足説明資料作成の有無 : 有  
決算説明会開催の有無 : 有 アナリスト・機関投資家向け

(氏名) 太田 邦正  
(氏名) 川村 浩一  
TEL 042-642-1701  
配当支払開始予定日 平成23年6月28日

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成23年3月期の連結業績(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	49,676	61.6	6,679	—	6,030	—	6,103	—
22年3月期	30,735	△32.8	△1,567	—	△1,874	—	△3,512	—

(注) 包括利益 23年3月期 6,170百万円 (—%) 22年3月期 △2,613百万円 (—%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	自己資本当期純利益 率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年3月期	148.10	147.95	14.6	8.2	13.4
22年3月期	△86.60	—	△8.9	△2.5	△5.1

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 一百万円 22年3月期 一百万円

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年3月期	77,038	44,928	58.2	1,086.96
22年3月期	69,485	39,050	56.0	944.06

(参考) 自己資本 23年3月期 44,801百万円 22年3月期 38,904百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年3月期	7,569	1,029	△4,399	16,194
22年3月期	2,075	1,237	△8,867	12,027

### 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
23年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00	412	6.8	1.0
24年3月期(予想)	—	5.00	—	—	—	—	—	—

・現時点では、平成24年3月期の配当について未定です。開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	25,500	8.2	2,800	△5.8	2,600	15.4	2,400	0.5	58.23
通期	54,500	9.7	7,000	4.8	6,600	9.4	6,200	1.6	150.42

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有  
② ①以外の変更 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

23年3月期	41,249,481 株	22年3月期	41,241,081 株
--------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

23年3月期	32,018 株	22年3月期	31,599 株
--------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数

23年3月期	41,214,192 株	22年3月期	40,557,228 株
--------	--------------	--------	--------------

#### ※ 監査手続の実施状況に関する表示

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表に関する監査手続は終了していません。

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する記述は、添付資料 1. 経営成績 をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	4
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	5
(4) 事業等のリスク	5
2. 企業集団の状況	7
3. 経営方針	8
(1) 基本方針	8
(2) 目標とする経営指標	8
(3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題	8
4. 連結財務諸表	9
(1) 連結貸借対照表	9
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	11
(3) 連結資本等変動計算書	13
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	15
(5) 継続企業の前提に関する注記	17
(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更	17
(7) 連結財務諸表に関する注記	17
(セグメント情報)	17
(1株当たり情報)	20
(重要な後発事象)	20
5. その他	21
(1) 生産、受注及び販売の状況	21
(2) 役員の異動	22

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### ① 当期の経営成績

##### [全般]

当期の当社をとりまく内外経済情勢は、欧州での財政赤字問題や日米欧の雇用問題、中東・北アフリカ地域の政情不安による原油価格高騰、日本の円高懸念などの課題を抱えつつも、各国の景気刺激策や中国など新興国の内需拡大に牽引されて、緩やかながら概ね順調に推移しました。3月11日の東日本大震災による未曾有の被害により当期末にかけ内外景気に不透明感が強まりましたが、当期への影響は限定的でした。

このような状況下、当社の主な販売先である半導体や自動車関連業界の市況も順調に回復し、設備投資も活発化、当社の受注高・売上高も順調に回復しました。

当期の受注高は 576 億 91 百万円（前期比 81.1%増）、売上高は 496 億 76 百万円（同 61.6%増）、営業利益は 66 億 79 百万円（前期は△15 億 67 百万円）、経常利益は 60 億 30 百万円（前期は△18 億 74 百万円）となりました。

三鷹旧本社売却に伴う特別利益 8 億 72 百万円、投資有価証券評価損 3 億 63 百万円、震災による特別損失 52 百万円などを計上した結果、税金等調整前当期純利益は 65 億 64 百万円（前期は△16 億 21 百万円）、当期純利益は 61 億 3 百万円（前期は△35 億 12 百万円）となりました。なお、当期より連結納税制度を採用しています。

当期より、収益計上基準において半導体製造装置本体の全て及び設置を伴う計測機器本体について設置完了基準を適用することとしました。従来の方法によった場合に比較して、当期の売上高が 8 億 30 百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ 3 億 31 百万円減少しています。

##### [事業別セグメントの状況]

#### A. 半導体製造装置部門

- (a) 半導体製造装置部門では、急拡大したスマートフォン（高機能携帯電話）、タブレットPCなどの需要増加や産業機器、通信インフラ機器、自動車関連半導体デバイスの堅調な需要などによって、半導体メーカー各社の設備投資が活発でした。当期半ば以降にパソコンやデジタル家電などが減速し投資に一服感が見られたものの影響は限定的で、検査工程向け、組立工程向け装置ともに総じて堅調に推移しました。設備投資先も、引き続き台湾、韓国、東南アジアなどアジア中心ながら、欧米にまで裾野が広がりました。

こうした動向を受け、当社主力製品ウェーハロービングマシン（検査工程向け装置）は台湾、東南アジア、アメリカなどで期を通して堅調に推移、ウェーハダイシングマシンやポリッシュ・グラインダ（組立工程向け装置）は投資一服の影響があったものの、韓国、東南アジア、中国などで比較的堅調に推移し、いずれの受注、売上も前期に比べ大きく増加しました。

この結果、当期の受注高は 405 億 38 百万円（前期比 88.5%増）、売上高は 346 億 27 百万円（同 69.2%増）、営業利益は 38 億 28 百万円（前期は△24 億 67 百万円）となりました。

- (b) 地域別の売上高は、国内売上高が前期比 102.9%増、海外売上高は前期比 58.6%増となりました。

## B. 計測機器部門

- (a) 計測機器部門では、主要ユーザーである自動車関連業界や工作機械業界において、中国などアジア新興国主体に市況が堅調に推移、これに我が国のエコカー補助金・減税制度を始めとする各国の需要喚起策効果が加わり設備投資は回復を続けました。更に当社グループとして、国内では航空機やエネルギー産業、官公庁や中堅・中小企業マーケット、海外では中国・東南アジア・インドなど新興国マーケットの開拓に注力しました。

この結果、当期の受注高は 171 億 52 百万円（前期比 65.7%増）、売上高は 150 億 48 百万円（同 46.5%増）、営業利益は 28 億 50 百万円（同 216.7%増）となりました。

- (b) 地域別の売上高は、国内売上高が前期比 37.9%増、海外売上高は前期比 77.9%増となりました。

## ② 次期の見通し

### [全般及び事業別セグメントの概況]

次期、平成 24 年 3 月期においては、引き続き中国を始めとするアジア新興国の経済成長が見込まれることに加え、欧米経済も堅調に推移するものと予想しています。東日本大震災は日本経済に大きな打撃となり一層の成長鈍化が見込まれますが、世界経済への影響の広がりについては見極めきれれておりません。

大震災による当社グループの生産設備、営業・サービス拠点等の被害は極めて軽微で、当社の生産や営業・サービスに与える影響は殆どありません。しかしながら幅広い業界で原材料や部材のサプライチェーンに混乱が生じており、当社のお客様、仕入先双方の製品受入状況には不透明な部分もあります。今回の業績予想では、あくまで現時点で想定し得る範囲内でこうした事情を勘案しましたが、今後継続的に情報収集、対応を行い、結果として当社グループの業績に重大な影響が見込まれる場合には速やかに公表いたします。

## A. 半導体製造装置部門

半導体市場は、前期に急拡大したスマートフォン（高機能携帯電話）やタブレット PC に加え、FA 等の産業機器や通信インフラ機器関連の需要も堅調で、牽引役アプリケーションの幅が広がっています。これに伴いモバイル DRAM や NAND フラッシュなどのメモリやパワー、アナログ半導体などの需要も堅調に推移すると予想しています。

このような状況下、当社はコア事業であるウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシン及びポリッシュ・グラインダを中心に、CMP 装置、ウェーハマニファクチャリングシステムなどの製品群について、顧客ニーズに合った新たな製品の開発や複合機化などを進めることで、旺盛な設備投資ニーズを取り込んでいくとともに新たな市場開拓を行なってまいります。

以上より、半導体製造装置部門の平成 24 年 3 月期の売上高は 370 億円を予想しています。

## B. 計測機器部門

計測機器部門につきましては、主要ユーザーである自動車関連業界や工作機械業界は、中国、東南アジアなどアジア新興国中心に設備投資を積極化させており、今期も引き続き海外市場主体に設備増強を進めるものと見込んでおります。

このような状況下、当社は、引き続き主要ユーザーである自動車関連業界や工作機械業界のニーズを的確に把握し受注に繋げるとともに、需要拡大が見込める中国、東南アジアなどアジア向け輸出の拡大や、「環境性能に優れた自動車分野」、「再生可能エネルギー分野」、「インフラ（建機・航空機）関連分野」の拡販に努めてまいります。

前期より開始した中国での現地生産を今期から本格拡大します。これにより従来以上にきめ細かくお客様のニーズを汲み上げることができ一層の市場開拓が進められると考えております。

以上より、計測機器部門の平成 24 年 3 月期の売上高は 175 億円を予想しています。

## (2) 財政状態に関する分析

### ① 資産、負債、及び純資産の状況

当期末の総資産は、前期末比 75 億 53 百万円増加し、770 億 38 百万円となりました。増加の主な要因は、現金及び預金が 41 億 67 百万円増加、受取手形及び売掛金が 32 億 85 百万円増加、仕掛品が 11 億 84 百万円増加、建物及び構築物、機械装置及び運搬具などの有形固定資産が 4 億 84 百万円減少、無形固定資産が 4 億 95 百万円減少、投資その他の資産が 5 億 83 百万円減少したことなどによります。

負債合計は、前期末比 16 億 74 百万円増加し、321 億 9 百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加 33 億 83 百万円などで流動負債が 54 億 83 百万円増加、借入金などの有利子負債が 42 億 44 百万円減少したことなどによります。

純資産は 449 億 28 百万円となり、自己資本比率は 2.2%増加し、58.2%となりました。

### ② キャッシュ・フローの状況

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より 40 億 54 百万円増加し、161 億 94 百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは 75 億 69 百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 65 億 64 百万円、仕入債務の増加 34 億 57 百万円、減価償却費 17 億 89 百万円、売上債権の増加 38 億 19 百万円、および棚卸資産の増加 14 億 38 百万円などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは 10 億 29 百万円の収入となりました。これは有形固定資産の売却による収入 9 億 86 百万円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、43 億 99 百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 38 億 88 百万円などによるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
自己資本比率 (%)	49.4	56.0	58.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	39.4	95.7	79.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	9.7	8.5	1.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	20.5	5.5	14.3

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

注 1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

注 2. 株式時価総額は、期末株価総値×期末発行済株式総数により算出しています。

注 3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。

注 4. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

### (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、半導体製造装置と計測機器において、最先端技術を駆使した世界 No. 1 商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様への継続的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考えています。

剰余金の配当につきましては、連結業績、財政状況、事業拡大のための投資及び株主様の長期的視点等を考慮して決定いたします。

当期末の配当につきましては、平成 22 年 11 月 10 日に公表しましたとおり 1 株当たり 5 円を予定しております。平成 22 年 12 月 1 日に実施済みの中間配当金 5 円と合わせ、年間配当金は 1 株当たり 10 円となります。

次期の配当につきましては、大震災の影響による不透明感はあるものの事業が堅調に推移することを見込み、中間配当 5 円を予定しています。期末配当につきましては、今後の業績動向を踏まえて検討いたします。何卒、ご理解のほどお願いいたします。

### (4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績、財政状態及びキャッシュ・フロー等の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

当社グループにおいては、これらのリスクの発生を防止、分散、或いはヘッジすることによりリスクの軽減を図っております。しかし、予想を超える事態が生じた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

なお、記載した事項は、当期末現在において、当社グループが判断したものでありますが、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではありません。

#### ① 市場の変動について

当社グループは、半導体製造装置と精密計測機器の事業を、日本・欧米・アジアなどグローバルに展開しています。いずれも高度情報化社会の進展の一翼を担う産業として、今後も拡大基調を続けていくものと考えますが、各事業での需要と供給のバランスや各地域の経済環境が悪化した場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ② 為替レートの変動について

海外への販売については、円建てを原則としておりますが、米国をはじめとする一部の地域、ユーザーに対しては米ドル建てとなっております。為替レートについて予期せぬ変動が生じた場合、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

#### ③ 資金調達の財務制限条項に係るリスクについて

当社グループは、安定的な資金調達を図るため、みずほコーポレート銀行などを主幹事あるいは引受先とするシンジケートローン契約、社債引受契約を締結しております。本契約には一定の財務制限条項が付されており、この条項に抵触した場合には当該金融機関より期限の利益喪失の権利行使をされる可能性があります。

④ 自然災害・事故災害について

当社グループは、生産活動の中断により生じる損害を最小限に抑えるため、製造設備に対し定期的な防災点検及び設備保守、また、安全のための設備投資を行っています。しかしながら、突発的に発生する災害や天災、不慮の事故などの影響で、製造設備等が損害を被った場合は、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

⑤ カントリーリスクについて

当社グループは、全世界で事業活動を行っており、各国それぞれの法的規制の下で最適な事業活動を行っていますが、各国における予期せぬ法的規制の変更により、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。また、日本及び進出先各国で、テロ・戦争・伝染病などの発生により、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

⑥ 知的財産権の保護について

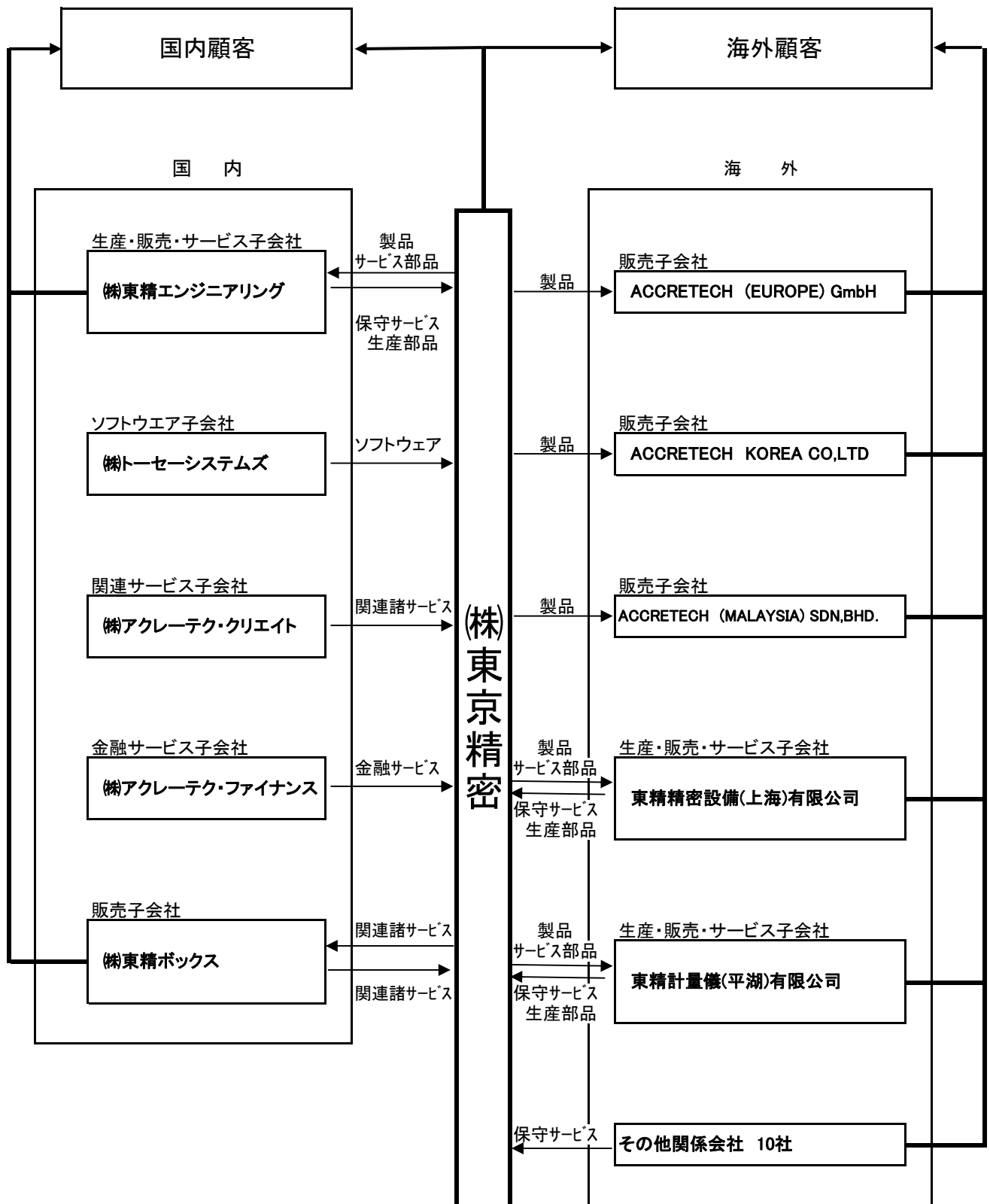
当社グループの製品は、半導体製造装置、精密計測機器いずれも最先端技術を搭載した製品であり、その技術関係の保護については特別の配慮をはらっています。特に特許関係の権利帰属、商標・ブランドの保護等については会社の利益が損なわれないように施策を講じていますが、日本及び海外において、やむを得ず第三者との権利関係をめぐる訴訟等が発生した場合、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

⑦ 技術革新について

当社グループの半導体製造装置、精密計測機器の分野では、新しい技術が日々開発されています。先端技術の開発と新規開発製品の提供は競争力の維持・強化のために必要不可欠ですが、当社グループの研究開発が常に成功する保証はありません。研究開発と製品化への努力が成功に結びつかなかった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

## 2.企業集団の状況

事業系統図



### 3. 経営方針

#### (1) 基本方針

- ① 当社グループは、計測機器および半導体製造装置メーカーとして、お客様の生産性向上に寄与する最先端の製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。前期、前々期と 2 期連続赤字を計上する厳しい経営環境下で事業の大胆な選択と集中や徹底したリストラを断行したことによりスリムで迅速な意思決定のできる経営体制となりました。当社グループは、この機会を第二の創業と位置づけ、企業成長の必須条件である「安全・健康」、「品質」、「環境・省エネルギー」「全員力」を経営の柱として、これまで培ってきた精密測定技術と精密加工技術を活かし、優れた計測機器と半導体製造装置を開発・供給することで、社会に貢献してまいります。
- ② 当社グループは、「WIN-WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう」を行動指針として制定しております。当社の培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、世界 No.1 の製品創りという共通目的をもつ国内外の会社および個人と“WIN-WIN”の関係を築くことにより、世界 No.1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。
- ③ 当社は、経営体制として、半導体社、計測社、業務会社の三つの社内カンパニー制と執行役員制を採用しています。各カンパニーは、完結した組織として責任と権限を有し、それぞれのお客様に機動的かつ迅速に対応することにより、顧客満足の上昇と業績拡大を目指します。

#### (2) 目標とする経営指標

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

- ① 当社グループは、金融危機に端を発した世界経済不況の中で、事業見直しなど大きな構造改革を実施し、第二の創業をスタートさせました。当社グループはこの機会を活かして、企業の足腰を強化し、品質向上と生産革新を推進し、売上増強と黒字体質の確立に努めてまいります。
- ② 当社グループは、平成 23 年 3 月期の中間配当より復配いたしました。企業価値を高め、株主の皆様に継続的に利益還元させていただくことが経営の重要課題であると認識し、業績の更なる改善と安定化に注力してまいります。
- ③ 企業のコーポレートガバナンスは一層重要性を増しています。当社は、実効性ある内部統制システムの構築とコンプライアンス体制の確立により、コーポレートガバナンスを強化し、経営の健全性と透明性を確保していきます。また、東日本大震災を踏まえ、リスク全般について見直しを行い、リスク対応力の強化を図ってまいります。
- ④ 当社グループは、海外売上高が過半を占め、子会社現地法人による営業が定着するとともに、中国では生産業務も開始しました。現地経営幹部の積極登用、グローバルネットワークの構築・増強、生産面での現地における調達体制の構築、本社との経営情報の共有化などの施策により、グローバル化に対応する経営体制の構築を進めてまいります。

将来の事象に係る記述に関する注意

この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

#### 4 連結財務諸表

##### (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	12,055	16,222
受取手形及び売掛金	15,511	18,796
商品及び製品	984	797
仕掛品	9,362	10,546
原材料及び貯蔵品	2,317	2,733
繰延税金資産	763	1,056
その他	911	910
貸倒引当金	△ 202	△ 245
流動資産合計	41,703	50,820
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	14,681	14,541
減価償却累計額	△ 6,628	△ 7,191
減損損失累計額	△ 134	—
建物及び構築物 (純額)	7,917	7,349
機械装置及び運搬具	5,398	5,667
減価償却累計額	△ 4,045	△ 4,480
機械装置及び運搬具 (純額)	1,352	1,187
工具、器具及び備品	3,544	3,725
減価償却累計額	△ 3,130	△ 3,284
減損損失累計額	△ 2	—
工具、器具及び備品 (純額)	411	440
土地	5,713	5,510
リース資産	1,840	1,598
減価償却累計額	△ 715	△ 830
リース資産 (純額)	1,124	767
建設仮勘定	945	1,725
有形固定資産合計	17,466	16,981
無形固定資産		
のれん	1,830	1,497
その他	590	428
無形固定資産合計	2,420	1,925
投資その他の資産		
投資有価証券	3,513	3,031
長期貸付金	48	97
繰延税金資産	3,955	3,860
その他	1,029	339
貸倒引当金	△ 652	△ 16
投資その他の資産合計	7,894	7,311
固定資産合計	27,782	26,218
資産合計	69,485	77,038

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,185	11,568
短期借入金	1,300	1,300
1年内返済予定の長期借入金	3,888	3,484
リース債務	323	306
未払法人税等	75	521
繰延税金負債	—	66
賞与引当金	245	643
役員賞与引当金	5	5
事業整理損失引当金	89	12
その他	1,596	3,284
流動負債合計	15,709	21,192
固定負債		
社債	3,000	3,000
長期借入金	8,384	4,900
リース債務	834	495
退職給付引当金	2,363	2,403
役員退職慰労引当金	114	88
長期未払金	29	29
固定負債合計	14,725	10,916
負債合計	30,435	32,109
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	10,198	10,209
資本剰余金	21,216	21,227
利益剰余金	7,987	13,805
自己株式	△ 107	△ 108
株主資本合計	39,294	45,134
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△ 194	△ 17
為替換算調整勘定	△ 195	△ 315
その他の包括利益累計額合計	△ 390	△ 332
新株予約権	146	127
純資産合計	39,050	44,928
負債純資産合計	69,485	77,038

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
 連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
売上高	30,735	49,676
売上原価	26,540	34,207
売上総利益	4,194	15,468
販売費及び一般管理費		
販売費	4,024	6,017
一般管理費	1,737	2,772
販売費及び一般管理費合計	5,761	8,789
営業利益又は営業損失 (△)	△ 1,567	6,679
営業外収益		
受取利息	21	5
受取配当金	118	49
為替差益	79	—
雇用調整助成金収入	135	—
貸倒引当金戻入額	78	71
その他	180	135
営業外収益合計	614	262
営業外費用		
支払利息	500	543
資金調達費用	278	—
為替差損	—	323
その他	142	43
営業外費用合計	921	910
経常利益又は経常損失 (△)	△ 1,874	6,030
特別利益		
土地売却益	—	872
新株予約権戻入益	187	—
事業整理損失引当金戻入額	222	—
投資有価証券売却益	1	—
その他	—	76
特別利益合計	411	948
特別損失		
投資有価証券評価損	—	363
災害による損失	—	52
減損損失	137	—
その他	21	—
特別損失合計	158	415
税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失 (△)	△ 1,621	6,564
法人税、住民税及び事業税	487	580
法人税等調整額	1,402	△ 119
法人税等合計	1,890	460
少数株主損益調整前当期純利益	—	6,103
当期純利益又は当期純損失 (△)	△ 3,512	6,103

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	6,103
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	177
為替換算調整勘定	—	△ 110
その他の包括利益合計	—	66
包括利益	—	6,170
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	6,170
少数株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月 31 日)
<b>株主資本</b>		
資本金		
前期末残高	9,650	10,198
当期変動額		
新株の発行	548	11
当期変動額合計	548	11
当期末残高	10,198	10,209
資本剰余金		
前期末残高	20,668	21,216
当期変動額		
新株の発行	547	11
当期変動額合計	547	11
当期末残高	21,216	21,227
利益剰余金		
前期末残高	11,500	7,987
当期変動額		
剰余金の配当	—	△ 206
当期純利益又は当期純損失 (△)	△ 3,512	6,103
連結範囲の変動	—	△ 79
当期変動額合計	△ 3,512	5,817
当期末残高	7,987	13,805
自己株式		
前期末残高	△ 107	△ 107
当期変動額		
自己株式の取得	△ 0	△ 0
当期変動額合計	△ 0	△ 0
当期末残高	△ 107	△ 108
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	41,712	39,294
当期変動額		
新株の発行	1,095	22
剰余金の配当	—	△ 206
当期純利益又は当期純損失 (△)	△ 3,512	6,103
自己株式の取得	△ 0	△ 0
連結範囲の変動	—	△ 79
当期変動額合計	△ 2,417	5,839
当期末残高	39,294	45,134

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△ 963	△ 194
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	769	177
当期変動額合計	769	177
当期末残高	△ 194	△ 17
為替換算調整勘定		
前期末残高	△ 326	△ 195
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	130	△ 119
当期変動額合計	130	△ 119
当期末残高	△ 195	△ 315
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△ 1,289	△ 390
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	899	57
当期変動額合計	899	57
当期末残高	△ 390	△ 332
<b>新株予約権</b>		
前期末残高	408	146
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 261	△ 18
当期変動額合計	△ 261	△ 18
当期末残高	146	127
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	40,830	39,050
当期変動額		
新株の発行	1,095	22
剰余金の配当	—	△ 206
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 3,512	6,103
自己株式の取得	△ 0	△ 0
連結範囲の変動	—	△ 79
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	637	38
当期変動額合計	△ 1,780	5,878
当期末残高	39,050	44,928

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失 (△)	△ 1,621	6,564
減価償却費	2,088	1,789
減損損失	137	—
のれん償却額	332	332
株式報酬費用	20	3
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,042	40
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	9	△ 25
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 178	△ 592
事業整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△ 311	△ 77
受取利息及び受取配当金	△ 139	△ 54
支払利息	500	543
新株予約権戻入益	△ 187	△ 0
有形固定資産除売却損益 (△は益)	81	20
土地売却損益 (△は益)	13	△ 872
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△ 75
投資有価証券評価損益 (△は益)	7	363
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 3,690	△ 3,819
たな卸資産の増減額 (△は増加)	5,459	△ 1,438
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,932	3,457
その他	△ 1,647	1,851
小計	2,766	8,010
利息及び配当金の受取額	139	54
利息の支払額	△ 530	△ 562
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 299	67
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,075	7,569
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△ 38	△ 38
定期預金の払戻による収入	1,038	38
有形固定資産の取得による支出	△ 181	△ 174
有形固定資産の売却による収入	382	986
無形固定資産の取得による支出	△ 4	△ 98
投資有価証券の取得による支出	△ 2	△ 2
投資有価証券の売却による収入	66	390
子会社株式の取得による支出	—	△ 14
子会社出資金の取得による支出	—	△ 8
出資金の払込による支出	△ 0	—
貸付けによる支出	△ 28	△ 51
貸付金の回収による収入	5	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,237	1,029

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△ 8,304	—
長期借入れによる収入	1,000	—
長期借入金の返済による支出	△ 5,199	△ 3,888
社債の発行による収入	3,000	—
株式の発行による収入	999	—
リース債務の返済による支出	△ 362	△ 304
ストックオプションの行使による収入	0	0
配当金の支払額	—	△ 206
その他	△ 0	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,867	△ 4,399
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 5	△ 145
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 5,559	4,054
現金及び現金同等物の期首残高	17,586	12,027
連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	113
現金及び現金同等物の期末残高	12,027	16,194

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

1. 連結の範囲に関する事項の変更

当連結会計年度より、東精精密設備(上海)有限公司及び東精計量儀(平湖)有限公司の2社については、重要性が増したため連結の範囲に含めております。

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

連結子会社のうち、東精精密設備(上海)有限公司及び東精計量儀(平湖)有限公司の期末決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、両社の期末決算日である12月31日現在の財務諸表を使用し、当連結会計年度末日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

3. 会計処理基準に関する事項の変更

当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響額はありません。

(7) 連結財務諸表に関する注記

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位:百万円)

	半導体製造 装置関連事業	計測機器 関連事業	計	消去 又は全社	連結
I 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	20,462	10,273	30,735	—	30,735
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	(—)	—
計	20,462	10,273	30,735	(—)	30,735
営業費用	22,929	9,373	32,302	(—)	32,302
営業利益又は営業損失(△)	△ 2,467	900	△ 1,567	—	△ 1,567
II 資産、減価償却費、 減損損失及び資本的支出					
資産	46,898	21,727	68,626	858	69,485
減価償却費	1,811	609	2,421	—	2,421
減損損失	114	22	137	—	137
資本的支出	131	15	147	—	147

(注) 1 当社の事業区分は製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して行っております。

2 各事業区分の主要製品

(1) 半導体製造装置関連事業 … ウェーハブロービングマシン、ウェーハダイシングマシン、ポリッシュ・グラインダー、ウェーハマニユファクチャリングマシン、CMP装置、

(2) 計測機器関連事業 …… 三次元座標測定機、真円度・円柱形状測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、マシンコントロールゲージ、電気マイクロメータ、各種自動測定・選別・組立機

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位:百万円)

	日本	米国	ドイツ	韓国	計	消去 又は全社	連結
I 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	27,574	1,734	1,094	332	30,735	—	30,735
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,027	—	18	210	2,257	(2,257)	—
計	29,602	1,734	1,113	543	32,993	(2,257)	30,735
営業費用	31,094	1,861	1,063	540	34,560	(2,257)	32,302
営業利益又は営業損失(△)	△ 1,492	△ 127	49	3	△ 1,567	—	△ 1,567
II 資産	66,421	1,729	1,327	252	69,731	(246)	69,485

(注) 国別の区分の方法

国別の区分の方法は事業活動の地域的独立性に基づいて決定しております。

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位:百万円)

	東アジア	東南アジア	北米	ヨーロッパ	その他地域	計
I 海外売上高(百万円)	11,658	3,423	1,431	996	243	17,752
II 連結売上高(百万円)	—	—	—	—	—	30,735
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	37.9	11.1	4.7	3.2	0.8	57.7

(注) 1 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

東アジア……………	韓国、台湾、中国
東南アジア……………	タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン
北米……………	米国、カナダ
ヨーロッパ……………	ドイツ、イタリア、フランス
その他の地域 ……	インド、メキシコ

【セグメント情報】

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社では、半導体社及び計測社の社内カンパニーそれぞれがその取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は社内カンパニーを基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「計測機器」の2つを報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」は、半導体製造工程で使用される加工・検査装置を製造販売し、「計測機器」は三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機等の精密測定機器類を製造販売しております。

② 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理は連結財務諸表の作成方法と概ね同一であり、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。なお、全社資産については各報告セグメントに配分をしております。

③ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務情報のセグメント情報として、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)等に準拠した場合と同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	半導体製造装置	計測機器	計		
売上高					
外部顧客への売上高	34,627	15,048	49,676	—	49,676
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	34,627	15,048	49,676	—	49,676
セグメント利益	3,828	2,850	6,679	—	6,679
セグメント資産	51,409	25,017	76,427	611	77,038
その他の項目					
減価償却費	1,284	504	1,789	—	1,789
のれんの償却額	78	253	332	—	332
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	916	190	1,106	—	1,106

(注) 1. セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産である、長期投資資金(その他有価証券)等であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

(追加情報)

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年 3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年 3月21日)を適用しております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)	
1株当たり純資産額	944.06 円	1株当たり純資産額	1,086.96 円
1株当たり当期純損失	△ 86.60 円	1株当たり当期純利益	148.10 円
なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、 1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	147.95 円

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 (平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (平成23年 3月31日)
連結貸借対照表の純資産の部の 合計額 (百万円)	39,050	44,928
普通株式に係る純資産額 (百万円)	38,904	44,801
差額の内訳		
新株予約権 (百万円)	146	127
普通株式の発行済株式数 (千株)	41,241	41,249
普通株式の自己株式数 (千株)	31	32
1株当たり純資産額の算定に 用いられた普通株式の数 (千株)	41,209	41,217

2. 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	前連結会計年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)
連結損益計算書上の当期純利益 又は当期純損失(△) (百万円)	△ 3,512	6,103
普通株式に係る当期純利益 又は当期純損失(△) (百万円)	△ 3,512	6,103
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式の期中平均株式数 (千株)	40,557	41,214
当期純利益調整額 (百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	—	40

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5. その他

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

(単位:百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)	(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)
半導体製造装置	16,609	33,542
計測機器	9,926	15,128
合計	26,235	48,670

(注) 1 上記生産実績は販売価額による。  
2 上記金額には消費税等は含まれていない。

② 受注実績

(単位:百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)		(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造装置	21,508	5,662	40,538	11,580
計測機器	10,350	1,869	17,152	3,967
合計	31,859	7,532	57,691	15,547

(注) 上記金額には消費税等は含まれていない。

③ 販売実績

(単位:百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)	(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)
半導体製造装置	20,462	34,627
計測機器	10,273	15,048
合計	30,735	49,676

(注) 上記金額には消費税等は含まれていない。

## (2) 役員の変動

(平成23年6月27日付予定)

### 新任監査役候補者

監査役(非常勤) 吉村善裕 現 SMBCインターナショナルビジネス株式会社  
代表取締役社長

\*会社法第2条第16号に規定する社外監査役候補者であります。

### 退任予定監査役

監査役(非常勤) 高田宥

\*会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。

以上